

# 开放式高峰论坛 A

ONSITE OPEN FORUM A

## 新型电子电气架构与车规芯片发展解决方案

联合主办单位：elexcon深圳国际电子展

🕒 8月24日 09:30-16:30 📍 深圳会展中心 4号馆，展馆内“开放式高峰论坛”区域

上午

时间

演讲内容及演讲嘉宾

09:30-09:35



开场及嘉宾介绍  
唐风敏  
国家智能网联汽车创新中心架构事业部总经理

09:35-10:00



英飞凌助力电子电气架构的演变  
文君培  
英飞凌大中华区 汽车电子事业部 车身与智能网联业务单元负责人

10:00-10:25



单 SoC 芯片方案加速汽车智能化转型  
额日特  
黑芝麻智能高级产品市场负责人

10:25-10:50



汽车半导体现状和紫光汽车芯片量产之路  
王旭芳  
北京紫光芯能科技有限公司首席市场营销官

10:50-11:15



智能汽车“存储”未来  
袁野  
得一微电子股份有限公司汽车电子市场负责人

11:15-11:40



可重构射频芯片在智能汽车中的应用  
李阳  
广州慧智微电子股份有限公司董事长 / 总经理

下午

时间

演讲内容及演讲嘉宾

13:30-13:35



开场及嘉宾介绍  
程强  
深圳市芯片科技促进会会长

13:35-14:00



电子电气架构和车载芯片是如何相辅相成的  
侯亚飞  
合众新能源汽车股份有限公司数字架构开发部高级总监

14:00-14:25



车规 MCU 芯片的产品规格管理与硅后全自动测试验证最佳实践  
陈嘉明  
上海孤波科技有限公司技术主管

14:25-14:50



中微半导体车规 MCU 赋能汽车电气化、数字化发展  
夏雨  
中微半导体（深圳）股份有限公司汽车电子事业部副总经理

14:50-15:15



IEEE 10BASE-T1S 标准使全以太网汽车成为现实  
张文  
微芯商贸（上海）有限公司汽车事业部高级市场经理

15:15-15:40



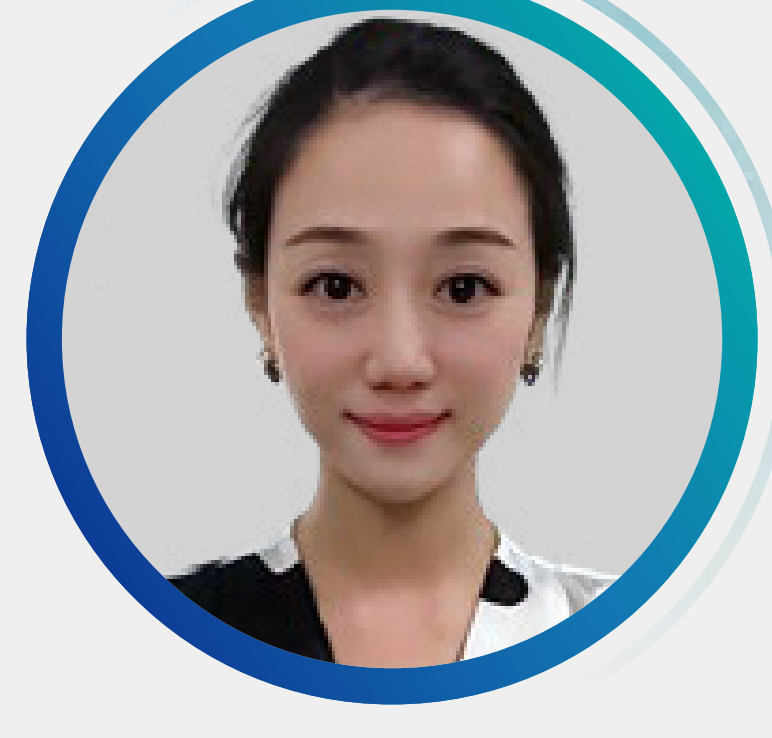
AEC-Q 的神话与现实  
陈韦良  
苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司项目部长

15:40-16:05



AI 芯粒产品助力智能汽车 SoC 芯片创新发展  
刘菲  
原粒（北京）半导体技术有限公司市场部总监

16:05-16:30



车载 MCU 创新及应用实践  
张娟苓  
芯海科技（深圳）股份有限公司品牌营销部总监